

SCHEDA TECNICA

ZM-R730A SISTEMA DI RILAVORAZIONE SCHEDE DI GRANDI DIMENSIONI

Sistema automatico per la rilavorazione di schede SMT che montano dai micro chip al grid array di grandi dimensioni e più complesso. Il pannello touch screen e lo schermo in alta risoluzione agevolano il lavoro dell'operatore, mentre un sistema di controllo automatico della testa di rifusione protegge i circuiti più delicati. I cicli automatici di rifusione per la saldatura e dissaldatura, sono in grado di riprodurre le condizioni ideali per la salvaguardia dei circuiti e dei componenti più sensibili. Telecamera e monitor HD, testina di posizionamento motorizzata per rotazione a 360° del componente.

Caratteristiche di base:

- Testa di reflow ad aria calda
- Preriscaldamento doppio (aria e IR)
- 5 sensori controllo Temperatura
- Precisione sensore 2-3°C
- Allineamento ottico di precisione
- Telecamera HD 2Mp 5X-50X
- Touch screen ad alta risoluzione
- Rotazione 360° del posizionamento
- Pressione di posizionamento <0.2N
- Saldatura e dissaldatura



Specifiche Tecniche:

Alimentazione/Potenza Assorbita	380/220VAC 50/60 Hz Max 7500W totali
Potenza riscaldatori ad aria	Superiore 1200W, inferiore 1200W
Potenza pre-riscaldatore IR	4800W (IR 420x435mm a riscaldamento rapido)
Temperatura dell'aria calda	400°C max, precisione 2-3°C (5 porte sensori)
Posizionamento	Portaschede anti warp, puntatore Laser
Precisione dell'allineamento	Tipicamente 0.01mm
Min/Max dimensione della scheda	6 x 6 mm / 645 x 520 mm spessore max 8 mm
Adatta per componenti	BGA, QGN, SCP, POP, QFN, LED, chip SMD
Min/Max dimensione dei componenti	3.0 x 3.0 mm / 80 x 80 mm
Dimensioni e peso	1000 (L) x 840 (P) x 950 (H) mm, 130 kg
Certificazione	CE

DATA SHEET

ZM-R730A REWORK SYSTEM LARGE BOARD

Automatic system for the rework of SMT boards ranging from micro chips to large and more complex grid arrays. The touch screen panel and high resolution screen facilitate the operator's work, while an automatic control system of the reflow head protects the most delicate circuits. The automatic reflow cycles for soldering and desoldering are able to reproduce the ideal conditions for safeguarding the most sensitive circuits and components. HD camera and monitor, motorized positioning head for 360° rotation of the component.

Basic Features:

- Hot air reflow head
- Double preheating (air and IR)
- 5 temperature control sensors
- Sensor accuracy 2-3°C
- Precision optical alignment
- 2Mp 5X-50X HD Camera
- High resolution touch screen
- 360° rotation of positioning
- Positioning pressure <0.2N
- Soldering and Desoldering



Specifiche Tecniche:

Power Supply/Power Consumption	380/220VAC 50/60 Hz Max 7500W tot.
Power air heaters	Upper 1200W, Lower 1200W
IR pre-heater Power	4800W (IR 420x435mm at rapid heating)
Hot Air temperature	400°C max, precision 2-3°C (5 sensors)
Positioning	Anti warp card-holder, Laser pointer
Precision alignment	Typically 0.01mm
Min/Max Board Dimensions	6 x 6 mm / 645 x 520 mm thickness max 8 mm
Suitable for components	BGA, QGN, SCP, POP, QFN, LED, chip SMD
Min/Max Components Dimensions	3.0 x 3.0 mm / 80 x 80 mm
Dimensions and weight	1000 (L) x 840 (P) x 950 (H) mm, 130 kg
Certification	CE